

Surfscan® SP A2/A3

无图案晶圆检测系统可以对半导体芯片上的各种关键的良率和可靠性缺陷及表面质量问题进行检测

优势：

Surfscan SP A2和 SP A3通过对关键缺陷进行高灵敏度和高产量的检测，协助芯片、晶圆和设备制造商实现工艺和工艺设备的认证和监控，并帮助汽车芯片制造商：

- 通过分析辨认可能影响芯片可靠性的随机缺陷的起源，在研发和量产中达成零缺陷的要求
- 实施持续改进计划，解决工艺设备缺陷的来源，确保所有工艺设备达到实现汽车可靠性目标的最低标准
- 确认汽车芯片制作流程中的最优性能的工艺设备

技术：

- DUV激光源和DUV优化光学系统
- 可同时运行的标准暗场和可选配的明场检测模式
- 自动缺陷和缺陷特征分类
- 先进的图像计算机和算法
- SURFmonitor™ 表面质量测量与表征模块
- SurfServer® 产线和菜单管理

应用：

- 晶圆的进厂和出厂质量控制
- 在大批量制造期间对材料、化学原料、工艺和工艺设备进行认证和监控
- 研发中的工艺表征、调试和认证



市场：

众多半导体制造领域，其中包括：

- 用于汽车、物联网、5G、消费电子、工业（军事、航空、医疗）的较大设计节点元件的芯片制造
- 晶圆制造
- 半导体设备和材料/化学原料制造

平台：

- 可定制的配置

晶圆尺寸：

- Surfscan SP A3:
300mm
- Surfscan SP A2:
200mm, 150mm

更多信息：

www.kla.com/products/chip-manufacturing/defect-inspection-review#product-sp-a2